

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2025-084

杭州长川科技股份有限公司

关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，公司对本次发行首次董事会决议日前六个月起至今已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证，对认定的财务性投资金额实施进一步扣减，调整了本次发行募集资金总额，将本次发行募集资金总额由不超过人民币 313,203.05 万元（含本数）调整为不超过人民币 312,703.05 万元（含本数），将补充流动资金项目的拟投入募集资金金额由 93,960.00 万元调整为 93,460.00 万元。与此同时，鉴于因限制性股票激励计划授予部分归属，公司总股本发生变动，根据公司本次向特定对象发行股票数量调整相关条款，本次向特定对象发行股票的发行数量上限由 188,648,115 股调整为 189,829,143 股。本次发行方案修订已经公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

公司本次发行方案具体调整内容如下：

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 188,648,115 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 189,829,143 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

2、本次发行募集资金投向

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 313,203.05 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	半导体设备研发项目	383,958.72	219,243.05
2	补充流动资金	93,960.00	93,960.00
	合计	477,918.72	313,203.05

注：“半导体设备研发项目”的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 312,703.05 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	半导体设备研发项目	383,958.72	219,243.05
2	补充流动资金	93,960.00	93,460.00
	合计	477,918.72	312,703.05

注：“半导体设备研发项目”的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案调整事宜无需提交股东大会/股东会审议。

本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日